

PALTEK、「第7回通販ソリューション展 春」に出展し Ranpak社の紙梱包資材活用による物流コストの低減を提案 ～「脱プラスチック」への対応を促進し、SDGs達成に貢献～

株式会社PALTEK(本社:横浜市港北区、代表取締役社長:矢吹尚秀、証券コード:7587、以下PALTEK)は、2019年5月8日(水)～10日(金)まで、東京ビッグサイトで開催されるJapan IT Week春 後期 内「第7回通販ソリューション展 春」に出展し、Ranpak社の紙梱包資材活用による物流コストの低減および関心が高まる「脱プラスチック」の促進について提案します。

現在、プラスチックは深刻な海洋汚染の原因となっており、さまざまな国や地域でプラスチック製品に規制を課す動きが活発になっています。また、中国が2017年末から廃プラスチックの輸入を禁止したことにより、世界的に「脱プラスチック」の流れが加速すると考えられています。加えて、物流資材費や運送料、人件費の上昇も懸念されており、物流コスト全般を低減するソリューションが今後ますます必要とされると考えられます。

PALTEKの提供するRanpak社の紙梱包資材システムは、独自の技術により高い緩衝能力を発揮し、梱包方法の最適化により梱包資材コストの低減、資材保管スペースの縮小などのトータルコストの大幅な削減を提案することができます。Ranpak社の紙梱包資材はFSC®認証(※)を受けた紙を使用しているため、環境保全に配慮されており、持続可能な社会をサポートします。また、梱包資材として使用されているプラスチック製品の置き換えが可能のため、「脱プラスチック」への対応も促進します。

「第7回通販ソリューション展 春」では、大量梱包ライン向けすき間埋め自動梱包システム「AccuFill®(アキュフィル)」の実演のほか、各物流ニーズにあわせた梱包システムを展示します。



「第7回通販ソリューション展 春」ブースイメージ

● 展示会の概要

展示会名 : Japan IT Week春 後期 内「第7回通販ソリューション展 春」
開催日時 : 2019年5月8日(水)～10日(金)
時間 : 10:00～18:00 (最終日は17:00まで)
会場 : 東京ビックサイト 西展示棟2F
PALTEKブースは、西16-18
主催 : リード エグジビション ジャパン株式会社
URL : <https://spring.japan-it.jp/ja-jp/about/direx.html>

2019 Japan IT Week 春 後期 内

第7回 通販ソリューション展 春

DIREX 春
ダイレックス

● 主な出展内容

・ 大量梱包ライン向けすき間埋め自動梱包システム(AccuFill®)

AccuFillは、すき間埋め用紙資材の量を最適化する自動梱包システムです。大量梱包ライン上の箱をAccuFillのセンサーがスキャンし、箱のサイズや箱内側の製品体積を測定し、すき間を埋めるために必要な紙資材の量を計算、FillPakコンバータに情報を送って必要な量の紙を排出します。



・ 高速すき間埋めシステム(FillPak®)

FillPakは、配送箱と製品とのすき間を高速に埋め、輸送中の揺れや衝撃を抑えます。ランダムに発生するさまざまなすき間を紙の柔軟性で容易に埋めることが可能です。



・ ラッピングシステム(Geami WrapPak®)

Geami WrapPakは、特許を取得したダイカット(切り込み)入りクラフト紙と台紙の組み合わせで商品を守り、迅速な梱包と美しい見た目を両立します。



・ 衝撃保護用梱包システム(PadPak®)

PadPakは、1枚の紙を折り畳んで「ひだ」を作り、保護能力がある衝撃吸収パッドに変えます。できあがった衝撃吸収パッドは、箱の中のクッション材や固定材として自在に利用でき、壊れやすい製品や重量のある製品を保護します。



■ 専門用語説明

※ FSC®認証:

FSC® (Forest Stewardship Council®、森林管理協議会)は、木材を生産する世界の森林と、その森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関で、その認証は、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも継続可能な形で生産された木材に与えられます。このFSCのマークが入った製品を買うことで、消費者は世界の森林保全を間接的に応援できる仕組みです。

Ranpak 社について:

Ranpak 社は世界初の環境問題に責任を持ったお客様の製品を保護する紙梱包資材を提供することを目標に 1972 年に設立され、世界に 230 社以上の代理店、400 箇所以上の拠点を有する世界最大の紙による梱包 資材・システムメーカーです。40 年以上にわたる経験から紙による緩衝材とすき間埋めの特許を 400 以上有し、世界で 6 万社のユーザーに提供しております。Ranpak BV は、欧州およびアジアに 100 以上の販売代理店を有しています。西ヨーロッパ(ドイツ、フランス、イギリスなど)の成熟市場、東ヨーロッパ(ポーランド、スロバキア、トルコ)の発展途上市場、およびアジア太平洋(オーストラリア、日本、シンガポールなど)など、世界中に拠点があります。

Ranpak 社に関する詳細は、<https://www.ranpak.com> をご覧ください。

株式会社PALTEKについて:

PALTEKは、1982年の創業以来、日本のエレクトロニクスメーカーに対して国内外の半導体製品の販売のほか、ハードウェアやソフトウェアなどの設計受託サービスも提供し、お客様の製品開発のパートナーとして仕様検討から試作開発、量産までサポートしています。

PALTEKは、「多様な存在との共生」という企業理念に基づき、お客様にとって最適なソリューションを提供することで、お客様の発展に貢献してまいります。

PALTEKに関する詳細は、<https://www.paltek.co.jp> をご覧ください。

■この件に関するお問い合わせは下記へお願いします。

1: ニュースリリースに関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 広報担当 柴崎 由記

メールアドレス : pr@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 6F

電話 : 045-477-2072 FAX : 045-477-2012

2: 本展示会に関するお問い合わせ

株式会社PALTEK

担当者 : 通販ソリューション展 担当者

メールアドレス : info_pal@paltek.co.jp

所在地 : 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-12 新横浜スクエアビル 11F

電話 : 045-477-2009 FAX : 045-477-2146